

46-704 / 46-705 Economy Version

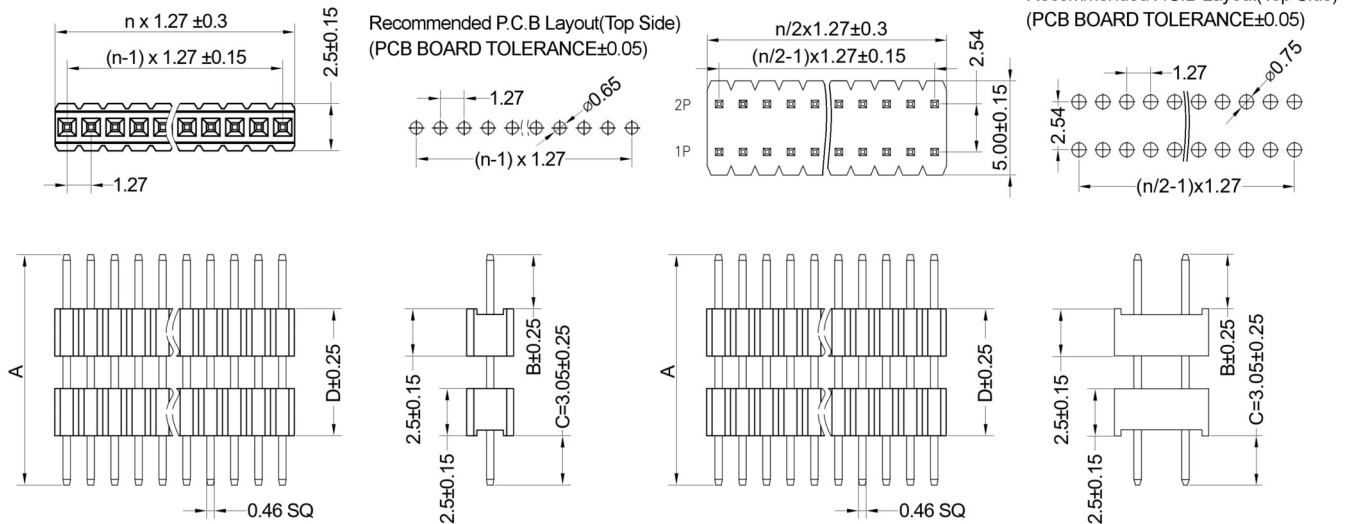
Sandwich-Stiftleisten RM 1,27x2,54mm, 1-/2-reihig
Dual Body Pin Headers, 1.27x2.54mm Pitch, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,64mm, Kupferlegierung <i>0.64mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Au über Ni <i>Au over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC/DC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden) <i>230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)</i>



Passende Buchsenleisten:
Compatible Female Headers:
46-709 46-710



Series*

46-704

46-704 Einreihig
Single row
46-705 Zweireihig
Double row

Contacts*

030

002-040 Einreihig
Single row
004-080 Zweireihig
Double row

Dimensions*

10

10 A=11,00 B=2,87 D=5,08mm
15 A=12,90 B=3,05 D=6,80mm
20 A=15,90 B=3,05 D=9,80mm
25 A=17,90 B=3,05 D=11,80mm
30 A=21,00 B=3,05 D=14,90mm
A- Kundenspezifisch (Einreihig max. 45,0mm, Zweireihig max. 21,0mm)
Customer-specific (single row max. 45.0mm, double row max. 21.0mm)

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Max. Polzahl für Stiftmaße zwischen 21,0 - 45,0mm = 20P
Max. contact number for dimensions between 21.0 - 45.0mm = 20P

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

